

Serveurs

LENOVO THINKSERVER TD230

Détails de la notation :

C-	NOTE RSE	>
D-	NOTE CYCLE DE VIE	>
E-	NOTE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE	>

Code EAN :

[VOIR LA FICHE CONSTRUCTEUR >](#)

[DÉCOUVRIR NOTRE MÉTHODOLOGIE >](#)

Gamme de prix

1000 – 2000 €



Le serveur **ThinkServer TD230** de **LENOVO** au format **Tour** propose une capacité de stockage de **2000 Go**.

Il est labellisé **Energy Star**.



ENERGY STAR

MATURITÉ RSE



C-

LENOVO publie un rapport RSE synthétique dans lequel les points clefs ESG sont abordés. LENOVO a récemment obtenu la certification ISO 5001 et poursuit des objectifs de réduction de consommation énergétique tout en rapportant les solutions mises en place et les performances réalisées. L'entreprise a pour objectif d'atteindre une totalité de fournisseurs n'utilisant pas de minerais de conflit. LENOVO concentre son programme d'inclusion des diversités sur l'accession aux postes clefs par des femmes et son aide aux communautés locales se focalise majoritairement sur l'éducation. Néanmoins, aucune politique claire n'a été prise concernant la consommation d'eau, et cette dernière apparaît en constante augmentation. Les objectifs environnementaux fixés par LENOVO concernent majoritairement l'Union Européenne et non pas la globalité des sites. Enfin, la politique d'inclusion des diversités reste sommaire et l'accessibilité aux produits ou le développement de produits destinés aux personnes handicapées n'est pas communiqué.

CYCLE DE VIE



D-

3 ans

De garantie

5 ans

De disponibilité des pièces

LES PLUS

- Possibilité d'extension ou d'échange de la mémoire
- Possibilité d'extension ou d'échange de la capacité de stockage
- Est garanti 3 années
- Pièces de rechange disponibles durant 5 années

LES MOINS

- Ne communique aucune information sur le respect de REACH

EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES

Masse de la RAM (Go)	2
Masse de la Mémoire Flash (Go)	Non-communicé
Masse de la carte mère	Non-communicé
Masse du microprocesseur + masse de la carte graphique ou la surface de silicium dans le microprocesseur la carte graphique	Non-communicé

FABRICATION

Utilisation de CFCs, HCFCs, 1.1.1 trichloro-ethane ou carbon-tetrachloride pour la production du produit final ou des modules le composant au sein du produit	Non-communicé
---	----------------------

DISTRIBUTION

Monomatière dans l'emballage	Non-communicé
Emballage sans PVC	Non-communicé

UTILISATION

Emission de COV (mg/h)	Non-communicé
Limitation des champs électromagnétiques créés par le produit	Non-communicé

DURÉE DE VIE EN PARC

Durée de garantie (année)	3
Disponibilité des pièces dans le temps (année)	5

FIN DE VIE

Exclu des substances au-delà des exigences réglementaires	Non-communicué
Identification des plastiques	Non-communicué
Contient des substances REACH	Oui
Contient du PVC dans les parties extérieures du produit	Non-communicué
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les plastiques	Non-communicué
Contient du mercure dans les sources de lumières dans l'électronique	Non-communicué
Contient des Retardateurs de Flamme Halogénés dans les circuits imprimés et dans l'électronique	Non-communicué
Contient du PVC dans l'électronique	Non-communicué
Présence de revêtement de surface pour les parties plastiques du boîtier/capots	Non-communicué
Communication du pourcentage de recyclabilité, selon le calcul IEC/TR 62635:2012	Non
Extension ou échange de la mémoire possible	Oui
Possibilité d'échange ou d'extension de la capacité de stockage	Oui
Parties et étiquettes facilement séparables	Non-communicué
Pièces plastiques monomatériaux ou facilement séparables	Non-communicué
Pièces plastiques sans incrustation métallique ou faciles à extraire avec les outils couramment disponibles	Non-communicué

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



E-

Dispositif d'économie d'énergie

Non

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Taille du rack (U)

Tour

Type de disque dur

SATA

Taille du disque dur

2000

Type de RAM

DDR3

Type de processeur

Intel Xeon séries 5500 et 5600

Cadence du processeur (GHz)

2

Carte DRAC

Non-communicé

Carte contrôleur

Non-communicé

Carte Réseau

Non-communicé

Dissipation calorifique (kj/h)

Non-communicé

Dimensions HxLxP (mm)

Non-communicé
